

# 第2世代Xeon® スケーラブル・プロセッサを2基搭載 ハイエンドGPU×1枚搭載可能



画像処理・マシンビジョン向け ミドルタワー型PC  
IPC-C621DPL-T

- 第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ搭載
- デュアルCPU搭載時、最大40コア搭載  
※Gold 6230プロセッサ
- インテル® C621 チップセット装備
- 最大2TBメモリー(DDR4)搭載可能
- LAN×2基、IPMI×1基を装備
- ハイエンドGPUボードが1枚搭載可能
- 信頼性の高いニプロン電源を搭載



## ☑ 長期供給の第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを選択可能

14nm世代の最新CPU「第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ」を2基搭載し、長期供給が可能なプロセッサを選択することができます。長期運用が想定される装置／システムへの組込みに適しています。

## ☑ 画像処理・マシンビジョン向け拡張ボードが増設できる優れた拡張性

IPC-C621DPL-Tに装備しているすべてのPCI Expressは、CPU側とダイレクトに接続しています。拡張ボードはPCH側を経由せず直接CPUと高速通信ができます。ハイエンドGPUやフレームグラバーボードなどを搭載しても処理速度の低下を招くことはありません。

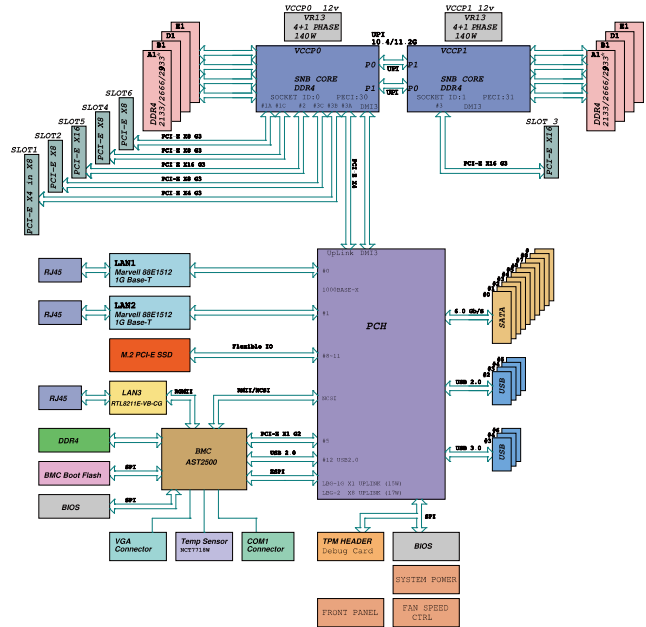
## ■製品仕様

モデル	IPC-C621DPL-T	
プロセッサ	種類	第2世代 インテル® Xeon® スケーラブルプロセッサ 【長期供給性 有】 Gold 6230 (20 コア 40 スレッド、2.10GHz、ターボ・ブースト時 3.90GHz、TDP125W) Gold 6226 (12 コア 24 スレッド、2.70GHz、ターボ・ブースト時 3.70GHz、TDP125W) Gold 5215 (10 コア 20 スレッド、2.50GHz、ターボ・ブースト時 3.40GHz、TDP85W) Silver 4215 (8 コア 16 スレッド、2.50GHz、ターボ・ブースト時 3.50GHz、TDP85W) 【長期供給性 無】 Gold 6234 (8 コア 16 スレッド、3.30GHz、ターボ・ブースト時 4.00GHz、TDP130W) Gold 6128 (6 コア 12 スレッド、3.40GHz、ターボ・ブースト時 3.70GHz、TDP115W) Gold 5222 (4 コア 8 スレッド、3.80GHz、ターボ・ブースト時 3.90GHz、TDP105W)
	搭載数	2
チップセット	インテル® C621 チップセット	
メモリー	規格	DDR4 2666MHz
	容量	標準 32GB (8GB × 4) ※最大 2TB
	スロット数	8
ストレージ	5 インチベイ	4
	3.5 インチベイ	内部 6 (空き 4) ※標準：システム用 480GB SSD × 1 (2.5 インチ変換マウントを使用。最大 2 台まで搭載可能) ※標準：データ用 1TB HDD × 1
	SATA コネクタ数	10 (空き 8) (SATA 3.0) ※標準：SSDx1、HDDx1で使用
グラフィックス	Aspeed AST2500 BMC	
I/O	VGA	1
	USB	前面 2 (USB3.0) / 背面 2 (USB2.0)
	LAN	2 (GbE)
	IPMI	1
拡張スロット	SLOT7: Non SLOT6: PCI-Express x8 スロット (Gen 3.0、x8 シグナル、CPU1 側) ※メモリスロットと位置が重なるため、カード長に制限あり SLOT5: PCI-Express x16 スロット (Gen 3.0、16 シグナル、CPU1 側) SLOT4: PCI-Express x8 スロット (Gen 3.0、x8 シグナル、CPU1 側) SLOT3: PCI-Express x16 スロット (Gen 3.0、x16 シグナル、CPU2 側) SLOT2: PCI-Express x8 スロット (Gen 3.0、x8 シグナル、CPU1 側) SLOT1: PCI-Express x8 スロット (Gen 3.0、x4 シグナル、CPU1 側)	
外形寸法	ミドルタワー W200mm × D488mm × H430mm (突起物等を除く)	
重量	TBC	
電源	ニプロン電源 822W (連続最大容量) / 1000W (ピーク容量)	
利用環境	入力電圧	AC90V ~ 240V
	温度	10℃ ~ 35℃
	湿度	20% ~ 80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10℃ ~ 55℃
	湿度	20% ~ 80% RH (結露なきこと)

## ■拡張スロット



## ■ブロック図



## ■I/Oポート



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部  
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階  
営業時間: 9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL: 03-5446-5535 mail: cto\_sales@hpc.co.jp  
WEBサイト: <https://embe.hpc.co.jp/>

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viviv、Intel Viviv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viviv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

2020年3月現在の内容です。